



2019年9月26日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 原口 直道  
(コード番号: 3918 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕  
(TEL. 03-6858-0530)

**当社半導体トータルソリューション事業再編に向けた株式会社レスターホールディングスへの  
子会社株式の一部譲渡（合弁会社化）並びに子会社合併に係る基本合意書締結のお知らせ**

当社は、2019年9月26日付にて、下記のとおり、半導体トータルソリューション事業の規模的拡大及び事業領域の拡大、並びに、資本業務提携先である株式会社レスターホールディングス（以下、「レスターホールディングス」という。）との更なる協業強化を目的に、①当社の完全子会社である株式会社シスウェーブ（神奈川県川崎市幸区、代表取締役社長 山下泰弘、以下「シスウェーブ」という。）の当社保有株式のうち一部をレスターホールディングスに譲渡すること（以下、「本株式譲渡」という。）、及び、②当社の連結子会社であり、レスターホールディングスグループとの合弁会社であるVSE株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 須藤裕二、当社による株式保有割合50%、以下「VSE」という。）とシスウェーブとが合併することに向けた協議開始に関する基本合意を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該株式の一部譲渡及び合併後におきましても、当社は当該会社の株式を50%以上保有し、引き続き当社の連結子会社となる予定であり、連結上の異動はありません。

記

1. 本株式譲渡による子会社合弁会社化及び子会社合併の概要及び目的

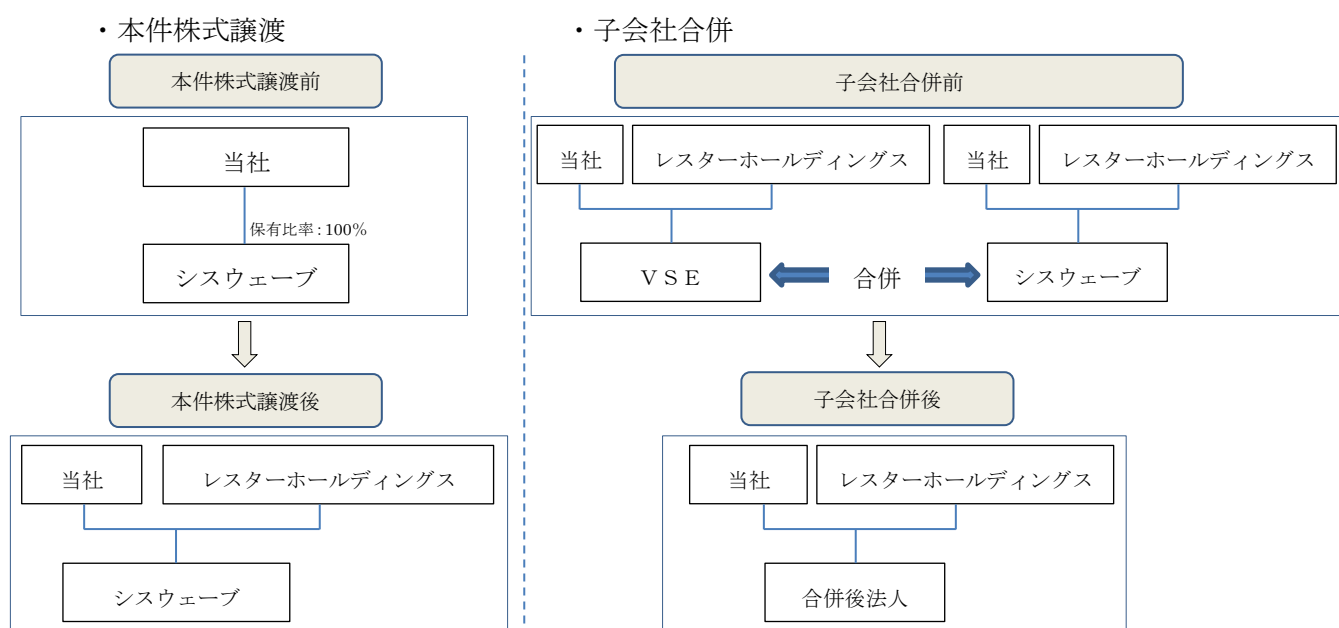
当社は、『ITを通じた「安心・安全・豊かな社会」への貢献』を標榜し、自動車産業、ネットワーク・通信関連分野、金融業界にて培った技術基盤を用いて、「IoT/IoE社会=Connected World」、「IIOT=Industrial Internet of Things（産業分野におけるIoT）」、「自動走行・自動運転・Connected Car」、「VR/AR」、「AI」等へのソフトウェア技術の提供、及び、「M&A」によるグループの拡大を成長戦略として掲げております。また、IoT/IoEソリューション事業における位置情報活用ソリューションの研究開発や情報セキュリティ関連サービスへの新規参入等、積極的に先端技術へ経営資源を投入してまいりました。

本株式譲渡による子会社合弁会社化及び合併（以下、「本再編」という。）は、当社の連結子会社であるシスウェーブの株式の一部を資本業務提携先であるレスターホールディングスへ譲渡し、VSEと同等の株式保有割合の合弁会社とした上で、その後当社の連結子会社であるVSEと合併させるスキームを採用いたします。AIやIoT需要の高まりを背景とした半導体関連市場の中長期的な拡大を見込み、当社グループにおける半導体トータルソリューション事業の規模的拡大及び事業領域の拡大を図るとともに、エレクトロニクス総合商社であるレスターホールディングスとの協業体制をより強固なものとし、半導体関連分野において当社グループの技術力をベースに新たな付加価値を生み出

し、最適な開発提案を行い、新たな市場・新たな顧客層とのビジネスを創出することを目的としております。本再編により、「ハードウェア+ソフトウェア+サービスの組み合わせ=ソリューションのトータル・コーディネート」を提供する組織が当社グループ内に整うこととなります。また、当社とレスターホールディングスとの資本業務提携契約締結の際に企図していた、以下の5つの効果がより促進されるものと考えております。

- ① 両社リソースの有効活用等、シナジー創出の加速
- ② 新規顧客層の獲得と包括的なソリューションの提供
- ③ 半導体・電子部品メーカーに対する高付加価値の創造
- ④ ハードウェア、ソフトウェアの融合による I o T / I o E ソリューション事業領域の拡大
- ⑤ セキュリティ分野の推進・発展

### 【本再編の概要図】



## 2. 当社グループにおける半導体トータルソリューション事業の変遷

### ① シスウェーブの子会社化

当社は、I o T / I o E 領域における半導体関連ノウハウ獲得を目的に、2016年11月にシスウェーブを完全子会社化し、半導体トータルソリューション事業を立ち上げました。シスウェーブの有する半導体の設計・テストにおける豊富な知見と、当社グループが従来から得意とする自動車及び通信関連の技術とを連動させることで、当社グループ内に「I o T / I o E 社会の循環構造」を構築いたしました。

### ② レスターホールディングス（旧株式会社バイテックホールディングス）との資本業務提携及びVSE（旧バイテックシステムエンジニアリング株式会社）の子会社化

当社は、得意とするソフトウェア開発技術に加え、よりエンドユーザーに近いハードウェアやプロダクトを活用した事業領域の拡大と提供サービスの充実を検討しておりました。この経営指針のもと、2018年6月にエレクトロニクス総合商社であるレスターホールディングスと資本業務提携契約を締結し、2018年9月に同社グループ会社であったVSEを当社の連結子会社といたしました。その結果、当社グループの強みであるエンベデッドソリューション事業及び半導体トータルソリューション事業の領域にVSEの技術が加わり、車載機器メーカー・大手電機メーカー・産業機器メーカー向けの開発案件をOne Stopで提供することが可能となりました。

3. 株式譲渡（一部）する当社子会社の概要

(1) 名 称	株式会社シスウェーブ
(2) 所 在 地	神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目17番5号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 西村 光太郎 代表取締役社長 山下 泰弘
(4) 事 業 内 容	LSI 設計受託、LSI テスト関連各種サービス等
(5) 資 本 金	90 百万円
(6) 設 立 年 月 日	2012 年 2 月 1 日
(7) 大株主及び持株比率	当社 100%

4. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社レスターホールディングス	
(2) 所 在 地	東京都品川区東品川三丁目6番5号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼 CEO 今野 邦廣 代表取締役社長兼 COO 栗田 伸樹	
(4) 事 業 内 容	半導体及び電子部品事業、電子機器事業、システム機器事業、植物工場事業等を営む会社の株式を保有する純粋持株会社	
(5) 資 本 金	43 億 83 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2009 年 10 月 1 日	
(7) 連 結 純 資 産	388 億 58 百万円 (2019 年 3 月期)	
(8) 連 結 総 資 産	973 億 61 百万円 (2019 年 3 月期)	
(9) 大株主及び持株比率	みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニー株	14.23%
	003 口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社	
	株式会社ケイエムエフ	6.52%
	BBH FOR FIDELITY LOW-PRI CED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTORSUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	6.20%
	株式会社エスグラントコーポレーション	5.73%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	4.22%	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	資本業務提携を締結しており、双方の株式を保有しております。
	人 的 関 係	当社連結子会社の役員に、当該会社グループの従業員が就任しております。
	取 引 関 係	当社子会社が当該会社グループからシステム開発業務を受託しております。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	記載すべき該当事項はありません。

5. 譲渡株式数、譲渡前後の所有状況

(1) 譲渡前の所有株式数	15,880株
(2) 譲渡株式数	7,940株(予定)
(3) 譲渡価格	未定
(4) 譲渡後の所有株式数	7,940株(予定)

6. シスウェーブと合併する当社子会社の概要

(1) 名称	V S E株式会社
(2) 所在地	東京都品川区北品川二丁目32番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 天野 豊美 代表取締役社長 須藤 裕二
(4) 事業内容	エレクトロニクス製品、電子回路、制御ソフト等の開発及び各種半導体技術サポート
(5) 資本金	1億円
(6) 設立年月日	1987年2月20日
(7) 大株主及び持株比率	当社 50% (連結) 株式会社レスターエレクトロニクス 50%

※(株)レスターエレクトロニクスの保有株式の全てが(株)レスターホールディングスに譲渡された後、当該合併を行う予定です。

7. 日程

(1) 本再編に係る基本合意書締結日	2019年9月26日(木)
(2) 株式譲渡に係る取締役会決議日及び株式譲渡契約書締結日	2019年11月中旬(予定)
(3) 合併に係る取締役会決議日及び合併契約書締結日	2019年11月中旬(予定)
(4) 合併契約効力発生日	2020年1月1日(水)(予定)

8. 業績に与える影響

シスウェーブとV S Eは合併後も当社連結子会社となる予定であり、本件に伴う2019年9月期連結業績に与える影響は軽微です。また、2020年9月期連結業績予想につきましては、2019年11月13日開示予定の「2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」にて公表いたします。今後、本再編に向けた協議の進捗に応じて公表すべき事項が発生した場合、速やかにお知らせいたします。

以上